



2024 年 9 月 27 日

## SWTest Asia 2024 技术演讲公告

[TESEC 株式会社](#)与[东京精密株式会社](#)将在日本福冈举办的 [SWTest Asia 2024](#) 上联合发表技术论文，内容如下：

- **活动时间：** 2024 年 10 月 24 日 ( 星期四 ) 至 2024 年 10 月 26 日 ( 星期六 )
- **地点：** 福冈海鹰希尔顿酒店
- **演讲日期：** 2024 年 10 月 25 日 ( 星期五 ) 14:00–14:30
- **主题：** “Challenge and Solutions in Wafer Testing from Perspective of Power Semiconductor Back-End Processes and Modules”  
《从功率半导体后段工艺及模块看晶圆测试的挑战及解决方案》
- **演讲者：** 鈴木 海 (Kai Suzuki · TESEC 公司)

\* 我们要向筑波大学的岩室教授表示感谢，感谢他为撰写这篇技术论文所提供的宝贵支持。

### [关于 SWTest Asia 2024]

[SWTest](#) ( 半导体晶圆测试 ) 是唯一一个专注于半导体晶圆及芯片级测试的国际会议，在美国已有 30 余年历史。

继去年在台湾举办之后，今年将首次在日本举办，名为'[SWTest Asia 2024](#)'。”

此致